



平成 28 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 東京ボード工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井上 弘之  
(コード：7815 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 尾股拓彦  
(TEL：03-3522-4138)

### (開示事項の経過) 千葉工場（仮称）建築に伴う社債の発行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 14 日付に開示いたしました「第二工場新設に関するお知らせ」に關しまして、千葉県佐倉市に建築中の千葉工場（仮称）の建築費用及び製造設備購入代金として、平成 28 年 9 月 20 日において、第 4 回無担保社債の発行により 25 億円の資金調達を行いましたのでお知らせいたします。

#### 記

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. 発行の目的      | 千葉工場（仮称）に係る建築費用及び製造設備購入代金                                  |
| 2. 社債の名称      | 東京ボード工業株式会社<br>第 4 回無担保社債                                  |
| 3. 社債総額       | 25 億円  |
| 4. 利率         | 0.18%  |
| 5. 発行日        | 平成 28 年 9 月 20 日   |
| 6. 償還方法       | 定時償還   |
| 7. 償還日        | 平成 31 年 3 月 20 日を第一回償還日とし、毎年 3 月 20 日<br>及び 9 月 20 日に償還する。 |
| 8. 利息支払期日     | 毎年 3 月 20 日及び 9 月 20 日（年 2 回払い）                            |
| 9. 年限         | 10 年   |
| 10. 払込金額      | 金額 100 円につき 100 円  |
| 11. 償還価額      | 金額 100 円につき 100 円  |
| 12. 保証人及び保証割合 | 株式会社三井住友銀行   |
| 13. 総額引受人     | 株式会社三井住友銀行   |
| 14. 今後の見通し    | 本社債の発行に伴う平成 29 年 3 月期の業績に与える影響<br>は、軽微であります。               |

以 上